

证券代码： 301369

证券简称： 联动科技

佛山市联动科技股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号： 投 2024-002

投资者关系活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他（请文字说明其他活动内容）
参与单位名称及人员姓名	1. 广东竣弘投资 陈翔； 2. 天风证券 骆奕扬； 3. 艾希资本 王磊。
时间	2024 年 3 月 1 日
地点	公司会议室
上市公司接待人员姓名	1、副总经理兼董事会秘书 邱少媚女士； 2、证券事务代表 梁韶娟女士。
投资者关系活动主要内容介绍	一、 公司基本情况介绍 (1) 主营产品介绍 公司成立于 1998 年，一直专注于半导体行业后道封装测试领域专用设备的研发、生产和销售。公司具备较为完善的产品线，主要包括半导体自动化测试系统、半导体激光打标设备、其他机电一体化设备，此外还有相应配件、维修服务。公司的半导体自动化测试系统主要用于检测晶圆以及芯片的功能和性能参数，包括功率半导体的测试、模拟类及数模混合信号类集成电路的测试；激光打标设备主要用于半导体芯片的打标。 成立后，公司推出首款激光打标设备，主要用于半导体分立器件的打标。得益于优异的产品性能，迅速得到了半导体封测客户的认可。而后凭借激光打标设备积累的客户资源、封测产线应用经验以及工业控制技术，公司自 2003 年起即开始进入分立器件测试系统领域，通过多年深耕封测行业的经验与技术积累，目前已经拥有自主研发的分立器件测试系统产品包括 QT-3000/4000/6000/8400 系列，涵盖小信号及中高功率分立器件测试，包括二极管、三极管、MOS-FET、IGBT、可控硅以及新一代半导体材料 SiC、GaN

等主流及新型分立器件, 并已实现了产品的国际化布局。特别是公司 QT-4000 系列功率器件综合测试平台, 主要针对功率器件测试, 能满足 1600A/6KV 高压源、超大电流源等级的功率器件测试要求, 能够实现半导体器件直流参数测试项目和动态参数测试项的一对一数据合并, 同时能够分别实现小信号分立器件和中大功率器件的多工位并行测试要求, 带来测试精度、测试效率及数据分析管理效率的大大提高, 顺应了市场变化趋势, 深受市场主流功率半导体客户的认可, 是公司销量较高的产品之一。

随着功率器件 CP 测试 (晶圆测试) 的需求逐渐增多, 为了提升测试效率, 客户对测试系统的并行测试能力不断提高。针对功率半导体和第三代半导体器件测试带来的新的测试需求, 公司推出了新产品 QT-8400 系列功率测试平台, 能够较好的满足了目前碳化硅、氮化镓等第三代半导体及功率半导体对高电压、大电流以及动态参数测试的要求。

(2) 产品应用环节

公司产品主要应用于半导体生产前道工序中的晶圆测试环节, 以及后道工序中框架或裸晶激光打标、KGD 测试、成品测试、激光打标/视觉检测等环节。KGD 测试是新的工艺技术环节, 随着制造成本的提升和合封器件的应用, 功率器件 CP 测试 (晶圆测试) 的需求逐渐增多, 半导体测试越来越注重每一环节的可靠性, 从而保证良率、降低成本。这些新的市场变化也将为测试设备企业带来更大的业务需求及市场空间。

经过多年的发展, 公司业务领域覆盖华东、华南、西南、中国台湾、美国、东南亚等国家和地区, 其中海外客户主要位于马来西亚、菲律宾等东南亚地区。近几年, 随着新能源、电动汽车等新的应用领域的发展, 公司的客户结构也有发生一些变化, 以前以半导体封测厂商客户为主, 现在以 IDM 模式的功率半导体厂商客户为主。

公司拥有一支优秀的人才队伍, 研发人员占公司员工总数 30% 以上, 至今仍不断发展壮大。

二、问答环节

1、公司产品交期一般多久?

回复: 公司产品交期一般为 2-3 个月, 如果为达到客户特定要求还需对产品进一步开发的话则可能需要更长的时间。公司外协比例较低, 相较于在核心环节外协加工占比较高的同业企业, 公司对所有核心生产环节均能够实现自主生产, 基于“以销定产”的生产模式及“小批量、多品种”的生产特点, 公司在生产计划性、环节协同性、产品质量控制、产品交货期等方面更有保障。

2、目前公司主营业务毛利率保持在相对较高的水平的原

	<p>因是什么？</p> <p>回复：一方面，公司的主营产品半导体自动化测试系统所涉及的技术门槛较高、研发所需投入较大，对于行业新进入者，较难在短期内全面掌握所涉及的技术，需要经过较长时间的技术储备和产品应用经验积累。由于行业进入壁垒较高，因此自主研发生产销售半导体测试系统的企业数量较少，行业集中度较高，因此公司客户粘性较强，公司议价能力较强。其次，公司的半导体自动化测试系统及激光打标设备具有较高的技术水平和技术附加值，在关键技术指标上能够达到同类产品的国内领先、国际先进水平，产品竞争力较强。另外，公司销售产品的过程中，为客户提供的技术支持服务也提高了产品附加值。</p> <p>3、请问公司今年的业务拓展重点是什么？</p> <p>回复：针对碳化硅的 CP 测试、KGD 测试以及模块测试的相关产品业务将是公司今年的重点布局方向。目前公司已经拥有自主研发的功率半导体测试系统产品包括 QT-3000/4000/8400 系列，在公司产品销售的比例较高，涵盖中高功率二极管、三极管、MOSFET、IGBT、可控硅、SiC 和 GaN 第三代半导体及功率模块的 CP 和 FT 测试。公司正在通过头部客户进行更多模块测试产品的验证测试，逐步进入客户供应链，在功率半导体测试产品业务上努力争取更多的市场份额。</p> <p>4、请问公司大规模数字集成电路测试系统的研发进展？</p> <p>回复：目前该产品仍在进行技术架构的进一步完善，公司将争取尽快完成机台的研发并推出市场。</p>
附件清单（如有）	无
日期	2024 年 3 月 1 日